

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年4月19日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2022年4月22日以通讯方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），备案金额不超过3亿元人民币（含3亿元），发行期限不超过3年（含3年）。募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，

包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

为保证本次债权融资计划顺利发行，公司拟提请股东大会授权经营层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟发行债权融资计划的公告》。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2022 年 5 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日